

AMR-2200G

ピーリングリフトオフ装置（ドライ方式）

Peeling Lift-Off Machine (Dry System)

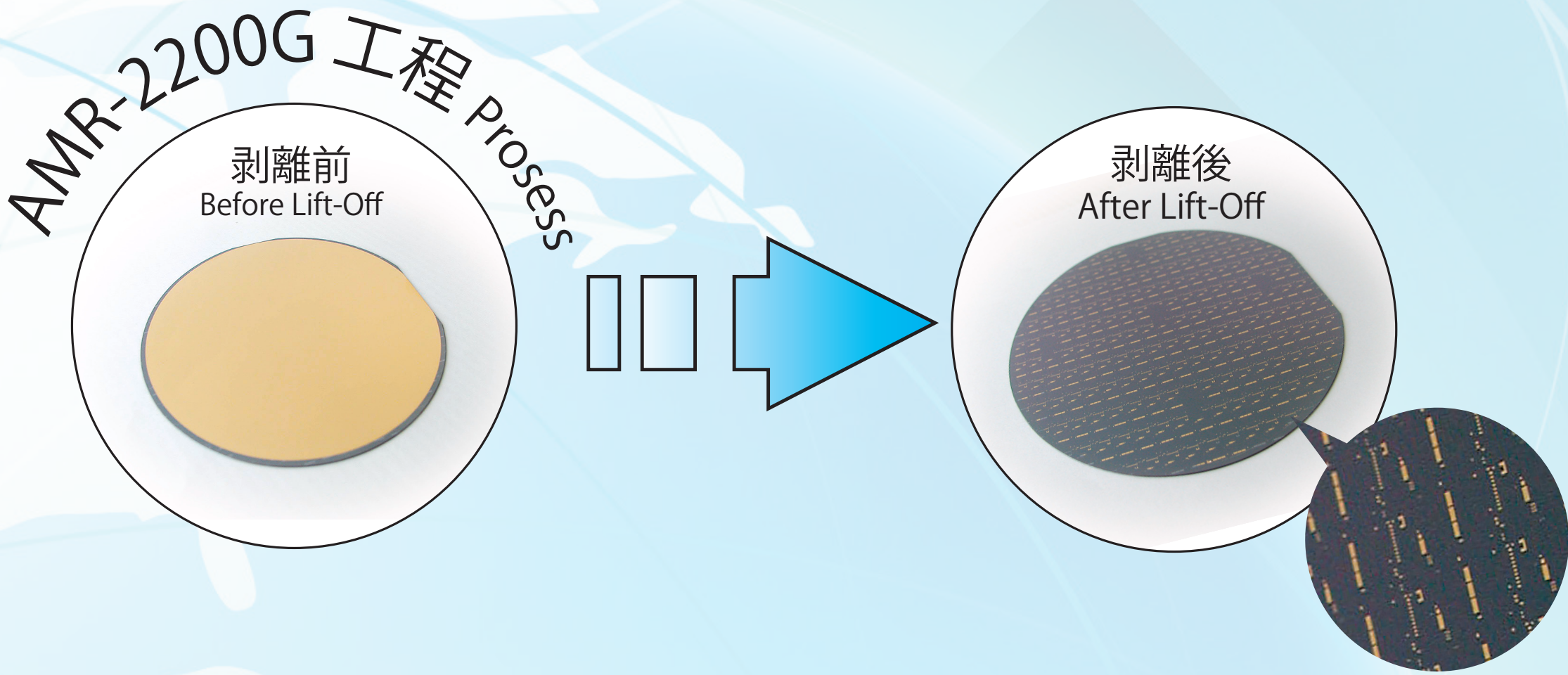
【概要－Outline－】

◆本装置は、UBM やバンプメッキ後のレジストマスク、金属膜の付着したリフトオフレジストマスクをピールオフ
The ideal system for dry peeling by Peel Off (Mechanical Peeling) that removes Lift Off Resist Mask with resist mask after UMB, plating for bump plating.
（機械的剥がし方式）で剥離するレジストのドライ剥離装置です。

【特長－Features－】

◆機械的ピーリング剥離方式の採用により、従来の剥離液による
Drastic saving the cost of usual liquid (usual wet system) and the cost of treatment of
レジスト除去方式の剥離液と廃液処理の費用を大幅に削減。
liquid waste can be done by adopting mechanical peeling system.
さらに、当社のドライレジスト貼り付け機と組み合わせることにより、
Moreover, by combination with our Dry Resist Tape Laminating Machine,
ドライレジストによるメッキ、リフトオフプロセスに対応し、
it corresponds with Plating process by dry resist,
液体レジストの回転塗布・ウェット剥離方式のレジストの
Lift Off process, drastic saving the cost of liquid and waste of resist
無駄・剥離液に費やされる材料コストを大幅に削減することが可能。
by spin coating in wet peeling process.
ウェハハンドリングでは、タカトリが薄ウェハ処理装置で
Takatori also can decrease wafer breakage, wafer crack by using Takatori unique technique
培った技術により、ウェハのフレ・カケを極限まで低減。
which has been developed with Takatori machines for thin wafers.

【AMR-2200G】



仕 様 Specification		AMR-2200G
スループット Throughput		40 枚 /h (ご使用条件により異なります Depend on data setting)
対応ウェハサイズ Wafer Size		3・4・5・6 inch (8inch は御相談に応じます 8 inch can be discussed)
使用テープ幅 Tape Width		ウェーハ径 +25mm Wafer diameter + 25 mm
ユーティリティ	電源 Power	AC100V 単相 Single phase 50/60Hz 1.5KVA
Utilities	空気源 air	圧力 Pressure 0.5~0.8Mpa 90NI/min
	真空源 Vacuum source	－74Kpa
装置寸法 Demension		D 1,025 × W 1,100 × H 1,650 mm
重量 Weight		450kg

※ 外観・仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。
System appearance and specifications are subject to change without prior notice from the supplier.